



Perfekte Laserschnitt-Kante mit SinglePico-Technologie

Für das Prototyping in Entwicklungsabteilungen und Forschungseinrichtungen präsentiert LPKF auf der Messe ein umfangreiches Portfolio. Hiermit lässt sich inhouse die komplette Leiterplattenproduktion realisieren. Für besonders anspruchsvolle Anwendungen setzt der Maschinenbauer auch hier auf Ultrakurzpuls-Laser.

Das dritte Messethema von LPKF ist die mit dem Innovation Award der productronica 2017 ausgezeichnete LIDE-Technologie. Mit dieser Innovation bietet LPKF das Prototyping und die Serienfertigung von Mikrostrukturen in Dünntstglas in beispielloser Qualität für eine Vielzahl von Anwendungen an.

[www.lpkf.de](http://www.lpkf.de)

Halle B1/Stand 219

### Zukunft der In-Vehicle Connectivity

Auf der electronica präsentiert Valens, Mitbegründer der HDBaseT-Alliance, seine aktuelle Technologie HDBaseT Automotive. Sie ermöglicht bis zu einer Distanz von 15 Metern High-Speed-Tunneling von Audio, Video, Ethernet, USB, PCIe mit nativen Netzwerkfunktionen über ein einziges, nicht abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabel (UTP). Dabei erfüllt HDBaseT Automotive die strengen EMV-Anforderungen der Automobilbranche. Gezeigt werden:

- Übertragung von PCIe-Daten über eine HDBaseT Automotive-Verbindung
- Die Fähigkeit von HDBaseT Automotive, auch PCIe-Signale bis zu einer Verbindungslänge von 15 Metern zu übertragen, vereinfacht durch die gemeinsame Nutzung von Steuergeräten, Multi-Gigabit-Funkmodems, SSDs und weiterer Komponenten die Realisierung komplexer Fahrzeugarchitekturen
- Konnektivität von Autotüren über ein einziges UTP-Kabel
- HDBaseT Automotive reduziert die Anzahl der an die Fahrzeigtüren gerouteten Kabel auf ein einzi-

ges Kabel, indem mehrere High- und Low-Speed-Schnittstellen zusammengeführt werden, wodurch das Gewicht reduziert und die Konnektivität optimiert wird

- Verbindungsdiagnose und Überwachung der Datenintegrität
- HDBaseT Automotive reduziert die Fehleranfälligkeit enorm und hält auf diese Weise das Daten-Tunneling über beeinträchtigte Verbindungen aufrecht, kompensiert Verbindungsmängel und ermöglicht Vorhersagen über potenzielle zukünftige Konnektivitäts-Störungen sowie Link-Assessments
- Konvergenz mehrerer ADAS-Anwendungen über eine HDBaseT Automotive-Verbindung

HDBaseT Automotive führt verschiedene ADAS-Anwendungen, etwa Kameras, Sensoren, LiDARs oder Fahrerüberwachungssysteme über eine einzelne Verbindung durch, um die Zuverlässigkeit und Sicherheit zu erhöhen. Dieses Szenario wird in Kooperation mit BrightWay Vision und Jungo präsentiert. BrightWay Vision bietet, basierend auf aktiver Gated-Imaging-Technologie – unabhängig von Wetter- oder Lichtverhältnissen – ein verbessertes Fahrerlebnis. Die Fahrerüberwachungslösung von Jungo für den Innenraum ermöglicht es OEMs, sicherere und autonomere Fahrzeuge zu bauen.

Auch der niederländische Chiphersteller STMicroelectronics zeigt auf seinem Stand die HDBaseT Automotive Technologie: „Der HDBaseT-Automotive-Chipsatz von Valens ist ein großer Schritt auf dem Weg zur vollständigen Revolutionierung der technologisch-automobilen Infrastruktur. Das gemeinsame Ziel ist, die heutige Connectivity-Technologie in Fahrzeugen auf den nächsten Level zu heben und die damit verbundenen Entwicklungen, mit Blick auf das Automobil von morgen, bereits heute maximal zu beschleunigen“, konstatiert Micha Risling, Leiter der Business Unit Automotive bei Valens. Sie wurde von Valens, wurde 2015 gegründet, um die weltweit fortschrittlichste Breitband-Technologie für die Automobilwelt bereitzustellen. Die patentierte HDBaseT-Technologie des in Israel ansässigen Unternehmens wird von den weltweit größten Herstellern von Audio- / Videokomponenten verwendet und ermöglicht höchste Verbindungsqualität ohne Einschränkungen über die vorhandene Infrastruktur.

[www.valens.com/automotive-solutions](http://www.valens.com/automotive-solutions)  
www.st.com

Halle B4/Stand 347  
Halle C3, Stand 101